

車載スイッチのインテリジェント化を実現するIPD

Building Intelligence into Automotive Switches



従来のメカニカルスイッチ(リレー)・保護ヒューズが抱える様々な課題は
半導体スイッチ(リレー)で解決出来ます

お客様にとって

- ・ 半導体化により、ユニットの小型化・軽量化・無音化・長寿命化(メンテナンスフリー)を実現
- ・ 小型化・無音化・メンテナンスフリー化により、ユニット設置場所の自由度が高まり、負荷の近くにユニットを設置可
- ・ 負荷の近くにユニットを設置する事により、車両内ワイヤーハーネス長を短縮、車両の軽量化へ貢献

エンドユーザーにとって

- ・ メカリレー・ヒューズに替えてIPDが使われる事により、メンテナンスフリーとなり、修理・交換の手間が減ります。
- ・ 車体の軽量化・消費電力削減に寄与する為、燃費向上やバッテリー消費低減に貢献します。
- ・ 高ロバスト性かつ様々な保護機能を搭載している為、車の安全性・信頼性が向上します。

製品ラインナップ

- ・ Gen2・Gen3を含めるとRon(Typ.)1.6mΩ~70mΩ、チャネル数1ch/2chの幅広いラインナップを取り揃えています。
- ・ 更に次世代製品の第一段として小型パッケージで高度な電流検出機能搭載品のサンプル出荷も開始されています。

評価環境

開発を強力に支援する、簡単便利な開発環境をそろえています。

- データシート、アプリケーションノート等のドキュメント 及び 代表製品を搭載した評価ボードも準備しております。

デバイス	評価ボード名	備考
RAJ2800024H12HPF	EV-IPD263-24H12 (TO-263-7 pkg用)	Ron(Typ.): 1.6mΩ

株式会社リョーサン

✉ techlab_customer_success@rsn.ryosan.co.jp



お問い合わせはこちら

本パンフレットに記載されている会社名、システム名、製品名およびロゴは各社の商標または登録商標です。
記載内容は発行日の情報であり、予告なしに変更することがあります。

2023年8月発行 SG2200058a